

NEWS RELEASE

光半導体事業の生産能力増強のため
本社工場に14棟を建設
地鎮祭は6月26日

2018年6月25日
浜松ホトニクス株式会社
本社：浜松市中区砂山町 325-6
代表取締役社長：晝馬 明(ひるま あきら)

当社は、光半導体モジュール製品の売上拡大に対応するため、本社工場（浜松市東区市野町）に新たに14棟の建設をします。

新棟建設の地鎮祭は6月26日に執り行い、2019年7月に竣工の予定です。



当社は、医療、科学計測、自動車などのさまざまな分野に光半導体素子、および光半導体素子に回路や光学部品、ソフトウェアなどを組み合わせた光半導体モジュール製品を供給しています。近年、お客様が容易に自社製品へ組み込むことができる光半導体モジュール製品への要求が高まっており、医療機器向けのMPPC®（Multi-Pixel Photon Counter）モジュールをはじめ、産業機器向けのミニ分光器やオプティクスモジュール、自動車向けの光半導体モジュール製品などの売上拡大が見込まれています。

新棟では、本社工場内に分散していた光半導体モジュール製品の開発部署を集約するとともに生産スペースを集約し拡張することで、光半導体モジュール製品の開発の迅速化と生産能力の拡充を図ります。また、製品倉庫および出荷機能を新棟に移転し、受注、調達、倉庫、出荷までの物流機能を本社工場に集約することで、業務の効率化、情報の共有化を図り顧客対応の迅速化を進めます。さらに、新棟への部署集約により発生した既存棟の空きスペースは、イメージセンサなどの光半導体素子の生産工程として利用することで、生産能力の増強を図ります。

新棟は、事業継続計画に基づく地震対策や防水扉などの水害対策を取り入れることで災害対策を強化するとともに、LED照明や断熱構造および太陽光パネルの設置などの環境対策も取り入れた設計となっています。

地鎮祭などの詳細につきましては次の通りです。

< 地鎮祭 >

式典名称 浜松ホトニクス株式会社 本社工場 14棟 地鎮祭
日 時 2018年6月26日（火） 午前10時00分～
場 所 静岡県浜松市東区市野町1126番地の1 本社工場7棟西側 14棟建設予定地

<新棟概要>

建物名称	本社工場14棟
建築場所	静岡県浜松市東区市野町1126番地の1 本社工場7棟西側
建築工期	2018年6月着工、2019年7月竣工予定
稼働予定	2019年10月
建築構造	鉄骨造 地上4階 地下1階
建物面積	建築面積2,441㎡、延床面積9,857㎡
施設構成	地下 倉庫 1階 物流エリア、製品倉庫、応接エリア 2階 光半導体モジュール製品の生産、事務所 3階 光半導体モジュール製品の生産 4階 光半導体モジュール製品の設計・評価、設計室、会議室、休憩エリア
総工費	約28億円
収容人員	約240名
生產品目	光半導体モジュール製品
生産能力	約100億円（売上高換算）

以上



本社工場 14 棟 完成予想図

この件に関するお問い合わせ先

■報道関係の方 浜松ホトニクス株式会社 広報室 野末迪隆
〒430-8587 浜松市中区砂山町 325-6 日本生命浜松駅前ビル
TEL053-452-2141 FAX053-456-7888 E-mail:nozue-m@hq.hpj.co.jp
時間外は、携帯電話 080-8262-0374 へお願いします